brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi

Bias 2008

Convegni, tavole rotonde e dibattiti si svolgeranno durante il Bias 2008, la Biennale Internazionale dell'Automazione, Strumentazione, Microelettronica e ICT per l'Industria, dal 27 al 30 maggio 2008 alla fiera di Rho. Opportunità di aggiornamento professionale durante le quali interverranno qualificati esponenti del mondo tecnologico e imprenditoriale legati alle aree dell'automazione industriale, della strumentazione, della microelettronica e dell'IT per l'industria.
In particolare ricordiamo la tavola rotonda 'Strumentazione wireless, applicazioni e realizzazioni' promossa da AIS/Isa Italy Section che prenderà spunto dalla recente introduzione sul mercato di soluzioni wireless basate sulla trasmissione dati a radio frequenza da parte dei principali produttori di strumentazione per impianti di processo. Oltre ai principi teorici della tecnologia wireless e all'attività dell'apposito comitato Isa SP-100 verranno affrontati gli aspetti legislativi dell'utilizzo delle radio frequenze, si discuterà di sicurezza dei dati e saranno esaminate alcune applicazioni, con casi reali. Nell'ambito della microelettronica sarà organizzato il convegno promosso da PCB Magazine, testata de Il Sole24Ore Business Media su 'PCB, mercati e stato dell'arte in Italia e in Europa' nel quale esponenti di realtà associative nazionali e internazionali forniranno l'analisi del mercato della produzione elettronica, oltre a un aggiornamento sullo stato dell'arte dei circuiti stampati. Nel corso della manifestazione si terranno una serie di eventi coordinati da Tecnoimprese. Tra questi, con il patrocinio di AIM-Italia, l'appuntamento 'Identificazione Automatica nel manufacturing: evoluzioni tecnologiche dal barcode al Rfid' affronterà un tema al crocevia tra elettronica, tecnologie informatiche e logistica. Ricordiamo poi il convegno 'Automazione per la qualità e la sicurezza nei processi industriali' promosso dal gruppo industria del Gisi in cui si discuterà di norme SIL e di PAT (Process Analytical Technology). E la tavola rotonda 'L'automazione e la strumentazione per il risparmio energetico negli impianti di processo' durante la quale saranno esaminati gli aspetti legislativi legati al risparmio energetico e verranno approfonditi temi quali l'utilizzo dei motori a giri variabili e i controlli non convenzionali, sempre finalizzati a risparmiare energia.

Freescale

Al via il concorso Freescale Technology Forum (FTF) Design Challenge Europe dove progettisti di sistemi embedded e studenti si sfideranno nello sviluppo di applicazioni particolarmente innovative e 'verdi', utilizzando avanzate tecnologie Freescale. In palio un montepremi complessivo di 61.000 dollari in contanti. Una volta iscritti, i partecipanti riceveranno un kit con tool di sviluppo hardware e software per dar vita ai loro progetti. Il 23 maggio sarà il termine ultimo per la presentazione del progetto finale, mentre il processo di valutazione si concluderà in occasione dell'FTF di Parigi che si terrà il 6 e il 7 ottobre dove i migliori classificati verranno premiati ufficialmente.

Passivi ma non troppo

Le aspettative per questo settore dei componenti elettronici sono buone ma su tutto pesa la crisi

ALESSANDRO FERRARI

Lo stato di salute dei componenti passivi per i prossimi tre anni dovrebbe essere buono. Il condizionale però è d'obbligo, considerata la situazione globale dei mercati finanziari e delle principali economie che segnano una crescita zero o un inizio di recessione. La situazione fino al 2011, secondo gli analisti, parrebbe sostanzialmente positiva soprattutto per i componenti realizzati con tecnologie innovative capaci di ridurre la dimensione e i consumi.
I condensatori chip MLCC (Multilayer Chip Type Ceramic Capacitor) di alto valore saranno sicuramente tra i componenti che incontreranno un successo crescente come alternativa ai condensatori all'alluminio e al tantalio, nonostante i lunghi tempi di attesa per alcuni dei valori capacitivi principali. I valori di capacità più alti richiesti dal mercato sono decisamente elevati per gli standard dei componenti MLCC ma grazie ai progressi della tecnologia multistrato è oggi possibile ottenere componenti di dimensioni inferiori rispetto a molte delle alternative tradizionali. I chip MLCC offrono, inoltre, i vantaggi di un'elevata stabilità, alta affidabilità e basso Esr a lungo termine. Questi componenti saranno particolarmente richiesti in alcune applicazioni quali: telefoni cellulari, notebook, TV a schermo piatto. Tali applicazioni richiederanno un grande numero di resistenze ultra piatte e induttanze multistrato. Se le applicazioni più affermate e consolidate saranno in grado di assorbire un buon numero di componenti, non è da sottovalutare la richiesta proveniente da nicchie di mercato emergenti che richiederanno diversi componenti passivi tra i quali: condensatori elettrolitici a montaggio superficiale, condensatori al tantalio, induttori a montaggio superficiale e altri componenti tecnologicamente avanzati come i condensatori a polimeri solidi che producono analoghi vantaggi rispetto ai tradizionali condensatori elettrolitici. Per quanto riguarda i componenti passivi a montaggio through hole, la principale novità è rappresentata dai condensatori boxed film. I mercati di nicchia emergenti sono visti con grande interesse perché, pur non garantendo grandi volumi di vendita, permettono margini di guadagno elevati.
Già dal 2009 la domanda di elevati quantitativi dipenderà da alcuni fattori: l'andamento della vendita di prodotti MP3, l'eventuale impatto della nuova piattaforma CPU di Intel, l'andamento del mercato della TV via cavo e ad alta definizione. Questi eventi stimoleranno un acquisto in larga scala dei componenti MLCC, condensatori al tantalio, resistori a film e componenti a montaggio superficiale. Fare una previsione per il 2010 e il 2011 risulta difficile: la visibilità su quanto può accadere è come sempre limitata. Nei prossimi 36 mesi la robotica, la domotica, i dispositivi elettronici portatili dovrebbero subire una rapida crescita determinando un 'effetto domino' con conseguente traino della domanda. Senza contare i mercati emergenti che in futuro potrebbero attrarre investimenti per lo sviluppo di componenti innovativi, come i condensatori all'ossido di niobio, i componenti passivi integrati a film sottile o anche i super condensatori. Diamo uno sguardo a quanto accade in Italia. Un'importante categoria dei componenti passivi è sicuramente quella dei connettori che trova largo impiego nei settori industriali tipici del nostro Paese: industriale e automotive. Dopo aver superato indenni la prima parte dell'anno, nell'ultimo trimestre si è verificata una battuta d'arresto. Tale dato è stato accolto con particolare preoccupazione perché da sempre gli ultimi mesi dell'anno sono quelli in cui la domanda è più alta. L'ottimismo dei produttori dimostrato alla chiusura del Q3 si è così smorzato. Il quarto trimestre ha portato una crescita Q-su-Q (ovvero rispetto al trimestre precedente) di un modesto +1% mentre le attese puntavano a un +10/15%, pari ai livelli tipici di questo trimestre.

Totale IP&E

Prod. Family	1Q06	2Q06	3Q06	4Q06	1Q07	2Q07	3Q07	4Q07	Q/Q-1 %	Q/Q-Y-1 %
Capacitors	23	24	20	20	23	22	19	21	10,3%	3,2%
Resistors	8	9	7	7	9	9	7	7	3,8%	1,9%
Other Passive	7	8	6	7	8	7	6	6	-5,4%	-6,7%
Connectors	19	20	15	16	20	20	16	17	6,2%	8,0%
E-mech	22	21	18	20	24	24	20	20	-2,1%	-0,3%
Total IP&E	79	82	65	69	84	82	68	71	3,5%	2,2%
YTD	79	161	226	295	84	166	234	305		
YTD/YTD-1%					5,5%	3,1%	3,7%	3,3%		

Rispetto al Trimestre precedente: 3,5%
Rispetto allo stesso Trimestre del 2006 2,2%
2007 vs 2006 3,3%

Prod. Family	2006	2007	07/06%
Capacitors	86	85	-1,7%
Resistors	30	32	3,9%
Other Passive	28	27	-3,2%
Connectors	69	73	4,8%
E-mech	80	88	9,5%
Total IP&E	295	305	3,3%

- Leggera flessione per Condensatori (@-1,7%) e "Altri Passivi" (@-3,2%);
- Buoni Resistenze (@+3,9%) e Connettori (@+4,8%);
- Ottimi gli Elettromeccanici (@+9,5%)